



CFP

TE 内部编号 2057630-1

CFP, Connector, .8mm [.031in] Centerline, Signal, Operating Temperature Range -55 – 85 °C [-67 – 185 °F], Data Rate (Max) 100 Gb/s, 148 Position

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 插拔式 IO 连接器和笼子



插拔式 I/O 产品类型: 连接器

中心线（间距）: .8 mm [.031 in]

可密封: 否

电路应用: Signal

工组温度范围: -55 – 85 °C [-67 – 185 °F]

产品特性

产品类型特性

插拔式 I/O 产品类型	连接器
可密封	否
外形尺寸	CFP

结构特性

位数	148
端口矩阵配置	1 x 1

电气特征

数据速率（最大值）	100 Gb/s
-----------	----------

主体特性

主要产品电镀材料	金
----------	---

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

--	--



PCB 安装方式	双面（前部对前部）
----------	-----------

壳体特性

中心线（间距）	.8 mm[.031 in]
---------	----------------

尺寸

PCB 厚度（建议）	2 mm[.079 in]
------------	---------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	Reel
------	------

产品合规性

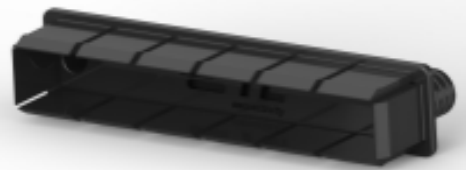
如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

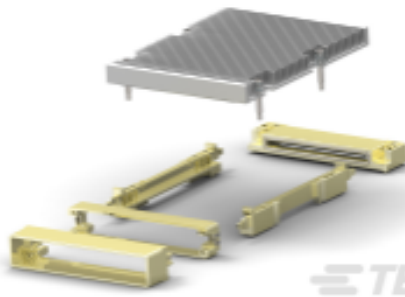
产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

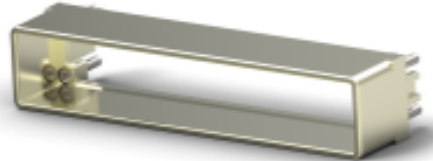
配套部件



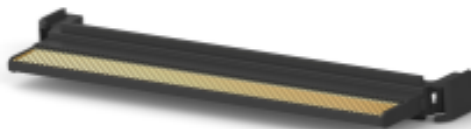
TE 产品编号 2149151-1
EMI/Dust Cover, CFP



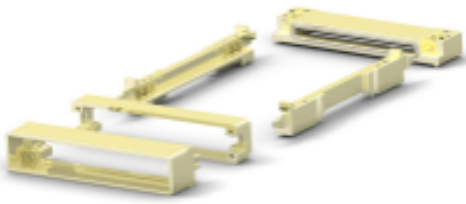
TE 产品编号 2180837-1
CFP Hardware Kit



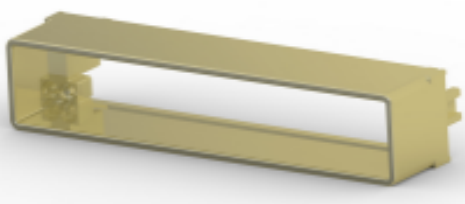
TE 产品编号 2169710-1
CFP External Bracket Assy



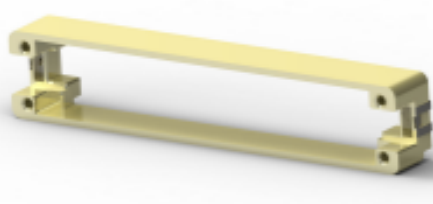
TE 产品编号 2057629-1
CFP Module Conn Assy



TE 产品编号 2227675-1
CFP HW Kit, No HS, No Clips



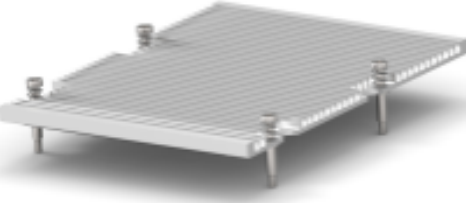
TE 产品编号 2057626-1
CFP External Bracket Assy



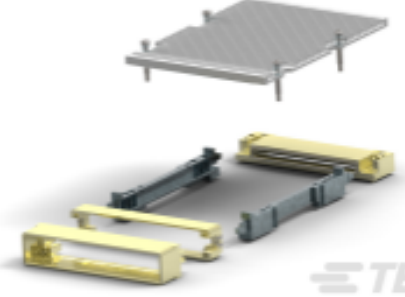
TE 产品编号 2057930-1
CFP Backer Plate Assy



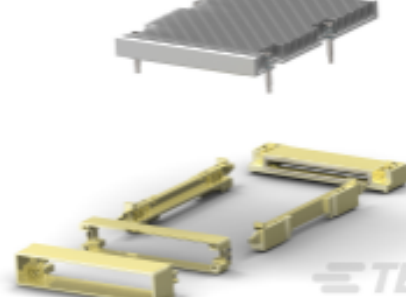
TE 产品编号 2180467-1
2-56 UNC x .375, CFP, External Bracket



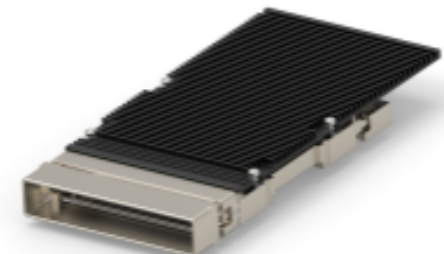
TE 产品编号 2274283-1
Heatsink Assembly, CFP



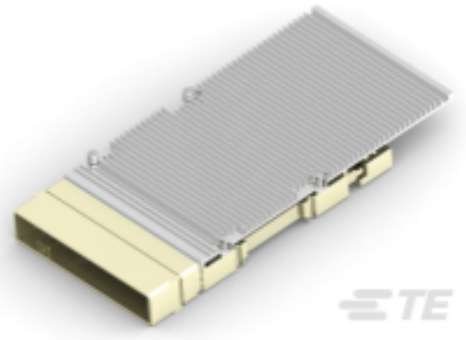
TE 产品编号 2274284-1
Hardware Kit, CFP, 5mm Heatsink



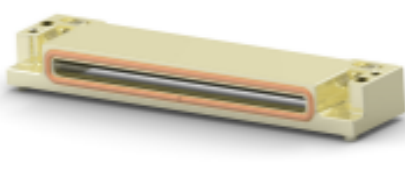
TE 产品编号 2132404-1
CFP Hardware Kit



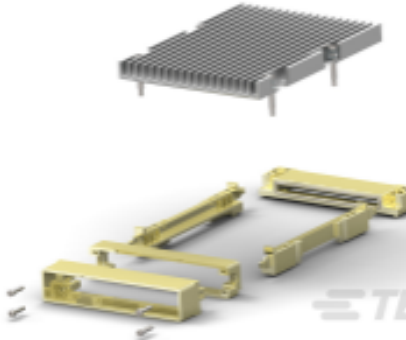
TE 产品编号 2300837-1
Hardware Kit, CFP, 5mm Heatsink



TE 产品编号 2300837-2
Hardware Kit, CFP, 5mm Heatsink



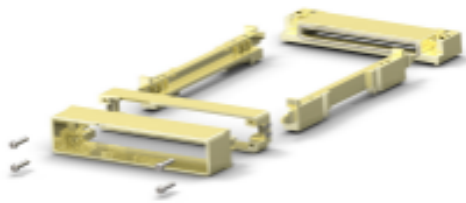
TE 产品编号 2057631-1
CFP Receptacle Cover Assy



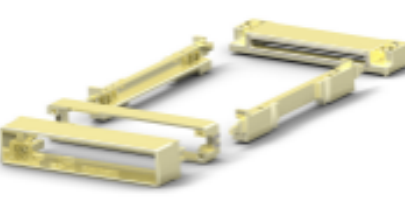
TE 产品编号 2227326-1
CFP HW Kit, w/FtB HS, 19 fin, 10.3mm



TE 产品编号 2057928-3
100G CFP Backer Plate, No Clips

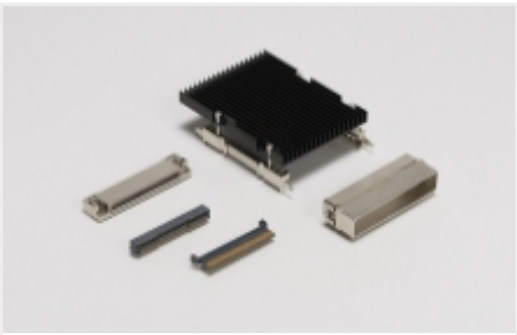


TE 产品编号 2169666-2
CFP HW Kit, No HS, With Clips and Screws

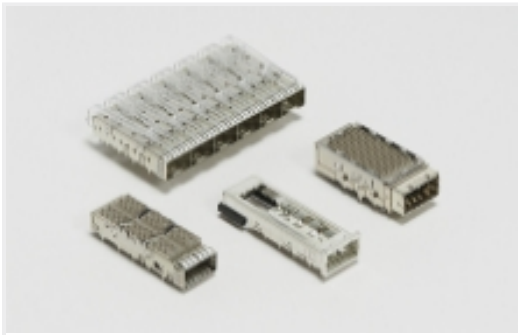


TE 产品编号 2169666-1
CFP HW Kit, No HS, With Clips

该系列中的其他产品 | CFP



CFP 、CFP2 和 CFP4(2)



插拔式 IO 连接器和笼子(2)



连接器盖帽(1)



连接器硬件(8)

客户还购买了



TE 产品编号1-338088-6
8/8 INV.MOD.JACK



TE 产品编号1934225-1
Tin Man Recept Assy 4 Pair 16 Column



TE 产品编号1982295-2
ELCON MINI 2P RA HEADER,W/O CODING



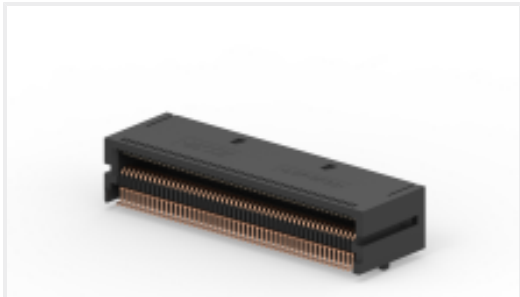
TE 产品编号CAT-SF59-C117ST123
SFP+ 堆叠壳体组件



TE 产品编号2007722-1
IMP100S,R,RA4P16C,RG,39



TE 产品编号2013289-1
SEMI-HARD TRAY DDR3 204P 5.2H STD



TE 产品编号2274845-1
CFP2 RECEPTACLE ASSEMBLY



TE 产品编号2434992-2
SOCKET E2 TFLM KIT WITH COVER



TE 产品编号2169802-1
IMP,PWR,4PR,R/A,Hdr,6.9,6.9,Tin

文档

产品图纸

CFP Receptacle Conn Assy

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2057630-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2057630-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2057630-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1-1773717-7_PLUGGABLE_IO_QRG_CN](#)

英文版本

[1-1773717-8_PLUGGABLEIO_QRG_TCN](#)

英文版本

[1-1773717-9_HIGH_SPEED_IO_QRG_JA](#)

英文版本

[CFP_40G_100G_ETHERNET_CONNECTORS](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本